



以下為本公司於二零零七年四月二十六日就截至二零零七年三月三十一日止三個月之未經審核業績在報章所作的報章公佈全文。

所有貨幣數字主要以美元列賬，除非特別指明。
報告內的財務報表數額按美國公認會計原則釐定。

概要

二零零七年第一季的銷售額與二零零六年第四季相比上升1.2%至3,300,000元，與二零零六年第一季度相比上升10.1%。
毛利率由二零零六年第四季的5.1%上升至二零零七年第一季的5.5%。
二零零七年第一季的淨收入為1,000,000元，二零零六年第一季淨虧損為1,000,000元，二零零六年第四季淨收入為100,000元。

中國上海 - 二零零七年四月二十六日國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公司(紐約交易所：)；香港聯交所：)(「中芯」或「本公司」)於今日公佈截至二零零七年三月三十一日止三個月的綜合經營業績。二零零七年第一季銷售額由上一季度的1,000,000元上升1.2%至3,300,000元。本公司的月產能減至1,500片吋等值晶圓，二零零七年第一季的使用率為5.5%。二零零七年第一季的毛利率為5.5%，二零零六年第四季毛利率為5.1%，與二零零六年第一季的淨虧損1,000,000元及二零零六年第四季的淨收入100,000元相比，二零零七年第一季為淨收入1,000,000元。

中芯國際公佈的2007年第一季度營收成果為1,000,000美元，中芯國際總執行長張汝京博士說：「2007年第一季度毛利增長為1,000,000美元，較2006年第四季度的500,000美元上升1.2%」，營收中包含了來自武漢和成都項目的管理費，證明中芯有持續發展業務的能力。

儘管面臨困難的商業環境，中芯有能力通過多種渠道在此季獲得收入的增長。我們的主要客戶已恢復部分訂單。在本季度，我們來自於中國當地設計公司的定單已有大幅增長，佔二零零七年第一季度營收的15%，而二零零六年第四季為10%。我們預期在今年繼續增長來自於中國當地設計公司的業務。

中芯將繼續致力於盈利並從戰略上選擇機會提升公司股東價值。5納米方面，我們正在技術里程上取得很好的進展。

在2007年第二季度，我們相信基於一流客戶先進技術的穩定發展連同追加的邏輯訂單和來自於其它商業機會的營收決定了我們在2007年有持續的增長。

電話會議 / 網上業績公佈詳情

日期：二零零七年四月二十七日

時間：上海時間上午十時正

撥號及登入密碼：美國 - 555-5555 (密碼：5555) 或香港 5-5555 (密碼：5555)。

二零零七年第一季業績公佈網上直播可於本公司網站「投資者關係」欄收聽。中芯網站在網上廣播後為期十二個月提供網上廣播錄音版本連同本新聞發佈的軟拷貝。

關於中芯國際
中芯國際(紐約證券交易所：)；香港聯合交易所：)總部位於中國上海，是世界領先的集成電路芯片代工公司之一，也是中國內地最大及最先進的芯片代工公司。向全世界客戶提供0.5微米到90納米及更先進工藝的芯片製造服務。公司在上海營運三座 6英寸芯片廠，在天津營運一座 6英寸芯片廠，並在北京營運一座 6英寸芯片廠，此為中國內地第一座正式營運之 6英寸芯片廠。此外，中芯國際還在美國、意大利、日本提供客戶服務和設立銷售辦事處，同時在香港設立了代表處。敬請訪問公司網站：<http://www.smic.com>

安全港聲明

(根據 5私人有價證券訴訟改革法案)

本次新聞發佈可能載有(除歷史資料外)依據 5美國私人有價證券訴訟改革法案的「安全港」條文所界定的「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述，包括涉及本公司的重大訴訟中芯計劃擴大其產能、基於並擴張產能來增加中國國客戶、預計折舊費用的減少、預期來自 0.5奈米產品銷售佔所有芯片總收入的百分比、中芯於二零零七年增加與改善獲利的能力。及包括在隨後「資本開支概要」和「二零零七年第二季度指引」中的聲明乃根據中芯對未來事件的現行假設、期望及預測而作出。中芯使用「相信」、「預期」、「計劃」、「估計」、「預計」、「預測」及類似表述為該等前瞻性陳述之標識，儘管並非所有前瞻性陳述均包含上述字眼。該等前瞻性陳述乃反映中芯高級管理層根據最佳判斷作出的估計，存在重大已知及未知風險、不確定性，以及其它可能導致中芯實際業績、財政狀況或經營結果與前瞻性陳述所載資料存在重大差異的因素，包括(但不限於)與半導體行業週期及市場狀況有關的風險、激烈競爭、中芯客戶能否及時接收晶圓產品、能否及時引進新技術、中芯量產新產品的能力、半導體代工服務供求情況、行業產能過剩、設備、零件及原材料短缺、製造生產量供給及最終市場的金融局勢是否穩定。

投資者應考慮中芯呈交予美國證券交易委員會(「證交會」)的文件資料，包括其於二零零六年六月二十九日以表格形式呈交予證交會的經修訂的年度報告，特別是「風險因素」及「有關財政狀況及經營業績的管理層討論及分析」兩個部份，以及其於二零零四年三月八日以A-表格形式呈交予香港聯合交易所(「香港聯交所」)的登記聲明，以及中芯可能不時向證交會及香港聯交所交出的該等其它文件，包括表格。其它未知或不可預知的因素亦可能會對中芯以往的業績表現或成就造成重大不利影響。鑒於上述風險、不確定性、假設及因素，本新聞發佈中提及的前瞻性事件可能不會發生。務請閣下注意，切勿過份依賴此等前瞻性陳述，此等陳述僅就本新聞發佈中所載述日期(或如無有關日期，則為本新聞發佈日期)的情況而表述。除法律有所規定以外，中芯概不就因新資料、未來事件或其它原因引起的任何情況承擔任何責任，亦不變更任何前瞻性陳述。

重大訴訟

台積電訴訟概覽

從二零零三年十二月起直至二零零四年八月，本公司成為臺灣積體電路製造股份有限公司(「台積電」)所指稱侵犯若干專利及挪用所指稱的有關經營半導體晶圓業務及製造集成電路方法之商業機密而起訴之若干法律訴訟的對象。

二零零五年一月三十一日，本公司與台積電訂立無承認責任之和解協議，規定在不損害雙方權利的前提下撤銷所有未決法律訴訟(「和解協議」)。和解協議亦包括：

- 本公司與台積電同意相互授權使用對方所有關於半導體器件產品的專利組合，於二零零五年一月至二零零六年十二月之期間內有效。
- 台積電承諾在特定條件下，不就先前台積電法律訴訟中所指稱本公司挪用其0.5微米及以上制程的商業機密再行起訴本公司(「台積電契諾」)。台積電契諾並不涵蓋和解協議簽訂(二零零五年七月三十一日)起計六個月之後的0.5微米及以下的制程技術。除0.5微米及以下制程技術外，台積電契諾並無期間限制，但本公司違約時得以終止。
- 本公司須將有關0.5微米及以下制程的特定資料存放於約定託管處直至二零零六年十二月三十一日，在特定情況下延至較長期限。
- 本公司同意向台積電分期支付合計共5,000,000美元。首五年每年分期支付1,000,000美元，第六年支付5,000,000美元。

和解協議之會計處理

即期會計處理

為核算和解協議，本公司認定和解協議存有若干部份 - 訴訟和解、台積電契諾、本公司授權台積電使用專利及台積電授權本公司於和解日期之前及其後使用其專利組合。

本公司認為 業務重估的會計處理是合適的。

會計估計變更

從二零零七年第一季度開始，本公司已經改變了用於計算年度折舊費用的與晶圓廠相關的機台和設備的估計使用年限。此改變已經影響了公司的毛利和毛利率。先前我們使用五年直線折舊法。我們認為之前的使用年限估計根據設備的預期經濟年限過於保守。我們已經將估計使用年限改變成5至10年，此改變符合行業慣例以及能更準確地反映設備所有權的經濟效益。

二零零七年第一季經營業績概要：

以千美元為單位(每股盈利和百分比除外)

	二零零七年 第一季度	二零零六年 第四季度	二零零六年 季度比較	二零零六年 第一季度	年度比較
銷售收入	3,300	3,200	1.0%	2,900	13.8%
銷售成本	2,300	2,200	4.5%	2,100	9.5%
毛利	1,000	1,000	0.0%	800	25.0%
經營開支	500	500	0.0%	500	0.0%
經營收益(虧損)	500	500	0.0%	300	66.7%
其他收入(支出)，淨額	(100)	(100)	0.0%	(100)	0.0%
所得稅利益(支出)	500	500	0.0%	500	0.0%
稅後淨收入(虧損)	500	500	0.0%	500	0.0%
少數股權	(100)	(100)	0.0%	(100)	0.0%
應佔聯營公司虧損	(100)	(100)	0.0%	(100)	0.0%
普通股持有人應佔收入(虧損)	500	500	0.0%	500	0.0%
毛利率	5.5%	5.1%	0.4%	5.0%	0.5%
經營利潤率	5.5%	5.1%	0.4%	5.0%	0.5%
每股普通股股份淨收入	0.0005	0.0005	0.0000	0.0005	0.0000
(虧損) - 基本	0.0005	0.0005	0.0000	0.0005	0.0000
每股美國預托股股份淨收入	0.0005	0.0005	0.0000	0.0005	0.0000
(虧損) - 攤薄	0.0005	0.0005	0.0000	0.0005	0.0000
每股美國預托股股份淨收入	0.0005	0.0005	0.0000	0.0005	0.0000
(虧損) - 攤薄	0.0005	0.0005	0.0000	0.0005	0.0000
付運晶圓(吋等值)	50.5	50.5	0.0%	50.0	1.0%
產能使用率	5.5%	5.1%	0.4%	5.0%	0.5%

附註：

(1) 基於二零零七年第一季加權平均普通股 5,000,000股(基本)及 6,000,000股(攤薄)，二零零六年第四季 5,000,000股(基本)及 6,000,000股(攤薄)，二零零六年第一季度 5,000,000股。

(2) 包括銅接連件。

二零零七年第一季銷售額升至3,300,000元，較二零零六年第四季的3,200,000元錄得季度升幅1.0%，並較二零零六年第一季度的2,900,000元錄得年度升幅13.8%。

銷售成本從二零零六年第四季的2,200,000元下降1.0%至二零零七年第一季的2,300,000元，主要是由於折舊費用下降所致。

與台積電和解相關的遞延成本攤銷已從經營費用重新分類至銷售成本的組成部份，呈報的所有期間都反映此調整，如此重新分類使二零零六年第四季及二零零七年第一季之毛利率下降了0.5%。

二零零七年第一季毛利增加至1,000,000元，較二零零六年第四季的1,000,000元錄得季度升幅0.0%；較二零零六年第一季度的800,000元錄得年度升幅25.0%。

毛利率由二零零六年第四季的5.1%上升至二零零七年第一季的5.5%，主要是由於管理服務費的取得及折舊費用下降所致。

總經營支出由二零零六年第四季的5,000,000元增至二零零七年第一季的5,000,000元，錄得季度升幅0.0%，主要是由於出售資產帶來的經營收入於二零零七年第一季下降所致。

二零零七年第一季的研發費用與二零零六年第四季持平。

一般行政費用由二零零六年第四季的1,000,000元上升至二零零七年第一季的1,000,000元，主要是由於與律師費用有關的一般行政費用增加及稅費增加所致。

二零零七年第一季的銷售及市場推廣相關費用下降至1,000,000元，較二零零六年第四季1,000,000元錄得季度降幅0.0%，主要是由於與銷售行為相關的工程材料耗用下降所致。

收入分析

銷售分析	二零零七年 第一季度	二零零六年 第四季度	二零零六年 第三季度	二零零六年 第二季度	二零零六年 第一季度
以應用分類					
銷售分析					
計算機	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
通訊	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.0%
消費	0.0%	0.0%	5.0%	0.0%	0.0%
其他	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
以裝置分類					
邏輯(包括銅接連件)	5.0%	5.0%	5.0%	0.0%	0.0%
記憶	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他(光罩製造及探測等)	0.0%	0.0%	5.0%	0.0%	0.0%
以客戶類別分類					
非原房半導體公司	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
集成裝置製造商	0.0%	55.0%	50.0%	0.0%	5.0%
系統公司及其他	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.0%
以地區分類					
北美洲	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.0%
亞太區(不包括日本)	0.0%	0.0%	5.0%	0.0%	0.0%
日本	0.0%	0.0%	5.0%	0.0%	0.0%
歐洲	5.0%	0.0%	5.0%	5.0%	0.0%

晶圓收入分析

各技術佔晶圓銷售額的百分比 (僅包括邏輯、記憶及銅接連件)	二零零七年 第一季度	二零零六年 第四季度	二零零六年 第三季度	二零零六年 第二季度	二零零六年 第一季度
0.5微米	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
0.6微米	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
0.8微米 / 0.9微米	0.0%	5.0%	0.0%	0.0%	0.0%
0.5微米	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
0.6微米	0.0%	5.0%	0.0%	0.0%	0.0%
各邏輯技術佔邏輯 晶圓銷售額百分比					
0.5微米	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
0.6微米	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
0.8微米 / 0.9微米	5.0%	5.0%	0.0%	0.0%	0.0%
0.5微米	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
0.6微米	0.0%	5.0%	0.0%	0.0%	0.0%

附註：

(1) 不包括0.5微米銅接連件

(2) 代表來自於全流程製造晶圓的銷售收入

產能：

廠 / (晶圓尺寸)	二零零七年 第一季度*	二零零六年 第四季度*
上海廠(吋)	50.5	50.0
北京廠(吋)	5.0	5.0
天津廠(吋)	0.0	0.0
每月晶圓裝配總產能	55.5	55.0

附註：

期終每月晶圓計 吋等值

(1) 上海廠是包括晶圓一廠、晶圓二廠、晶圓三廠。

(2) 北京廠是包括晶圓四廠、晶圓五廠、晶圓六廠。

截至二零零七年第一季末，每月產能下降至50.5片吋等值晶圓，主要是由於部分中芯國際處置部份資產至成都成芯半導體製造有限公司。

付運及使用率：

吋等值晶圓	二零零七年 第一季度	二零零六年 第四季度	二零零六年 第三季度	二零零六年 第二季度	二零零六年 第一季度
付運晶圓(包括銅接連件)	50.5	50.5	50.5	50.5	50.0
使用率	5.5%	5.1%	5.0%	5.0%	5.0%

附註：

(1) 產能使用率按輸出晶圓總線除以估計產能計算
二零零七年第一季晶圓付運增加至50.5片吋等值晶圓，較二零零六年第四季的50.5片吋等值晶圓及二零零六年第一季度的50.0片吋等值晶圓分別錄得季度升幅1.0%及年度升幅1.0%。

詳細財務分析

毛利分析

以千美元計	二零零七年 第一季度	二零零六年 第四季度	二零零六年 季度比較	二零零七年 第一季度	年度比較
銷售成本	2,300	2,200	4.5%	2,100	9.5%
折舊	500	500	0.0%	500	0.0%
其他製造成本	500	500	0.0%	500	0.0%
遞延成本調整	500	500	0.0%	500	0.0%
毛利	1,000	1,000	0.0%	800	25.0%
毛利率	5.5%	5.1%	0.4%	5.0%	0.5%

銷售成本從二零零六年第四季2,200,000元下降1.0%至二零零七年第一季的2,300,000元，主要是由於折舊費用下降所致。

與台積電和解相關的遞延成本攤銷已從經營費用重新分類至銷售成本的組成部份，呈報的所有期間都反映此調整。

二零零七年第一季毛利上升至1,000,000元，與二零零六年第四季的1,000,000元相比錄得季度升幅0.0%，與二零零六年第一季度的800,000元相比錄得年度升幅25.0%。

毛利率(不包括與台積電和解相關的遞延成本攤銷)由二零零六年第四季的5.1%上升至二零零七年第一季的5.5%，主要是由於管理服務費用所得增加及折舊費用下降所致。

經營開支分析

以千美元計	二零零七年 第一季度	二零零六年 第四季度	二零零六年 季度比較	二零零六年 第一季度	年度比較
總經營開支	5,000	5,000	0.0%	5,000	0.0%
研究及開發	0	0	0.0%	0	0.0%
一般及行政	500	500	0.0%	500	0.0%
銷售及市場推廣	0	0	0.0%	0	0.0%
無形資產攤銷	0	0	0.0%	0	0.0%
資產處置收入	(0)	(0)	0.0%	(0)	0.0%

總經營支出由二零零六年第四季的5,000,000元增至二零零七年第一季的5,000,000元，錄得季度升幅0.0%，主要是由於出售資產帶來的經營收入於二零零七年第一季下降所致。

二零零七年第一季的研發費用與二零零六年第四季持平。

一般行政費用由二零零六年第四季的1,000,000元上升至二零零七年第一季的1,000,000元，主要是由於與律師費用有關的一般行政費用增加及稅費增加所致。

二零零七年第一季的銷售及市場推廣相關費用下降至1,000,000元，較二零零六年第四季1,000,000元錄得季度降幅0.0%，主要是由於與銷售行為相關的工程材料耗用下降所致。

其它收入(支出)

以千美元計	二零零七年 第一季度	二零零六年 第四季度	二零零六年 季度比較	二零零六年 第一季度	年度比較
其他收入(支出)	(100)	(100)	0.0%	(100)	0.0%
利息收入	(500)	(500)	0.0%	(500)	0.0%
利息支出	(500)	(500)	0.0%	(500)	0.0%
其他，淨額	(100)	(100)	0.0%	(100)	0.0%

二零零七年第一季其它非經營性虧損為1,000,000元，二零零六年第四季度的虧損為1,000,000元，主要是與上一季度與非經營性活動相關的匯兌虧損相比，本季為匯兌收益。

相較於二零零六年第四季度的利息收入1,000,000元，二零零七年第一季的利息收入為1,000,000元，此下降是由於本季平均所持現金餘額較低所致。

二零零七年第一季的利息支出為5,000,000元，較二零零六年第四季度的5,000,000元錄得季度升幅0.0%。

流動資金

以千美元計	二零零七年 第一季度	二零零六年 第四季度
現金及現金等價物	0	0
短期投資	0	5,500
應收賬款	0	5,500
存貨	0	5,500
其他	0	0
流動資產總計	0	16,500
應付賬款	0	0
短期借款	0	0
長期借款的即期部份	0	0
其他	0	0
流動負債總計	0	0
現金比率	0	0
速動比率	0	0
流動比率	0	0

資本結構

以千美元計	二零零七年 第一季度	二零零六年 第四季度
現金及現金等價物	0	0
短期投資	0	5,500
長期票據即期部分	0	0
長期票據	0	0
短期借款	0	0
長期借款的即期部份	0	0
長期借款	0	0
總負債	0	0
現金淨額	(0)	(0)
股東權益	0	0
總權益對權益比率	0.0%	0.0%

現金流量概要

以千美元計	二零零七年 第一季度	二零零六年 第四季度
淨收入(虧損)	0	0
折舊及攤銷	0	5,500
購入無形資產攤銷	0	0
現金變動淨額	(0)	(0)

資本開支概要

二零零七年第一季資本開支為0.00,000元。

計劃下的二零零七年資本開支總額將約為0.000,000元。並將基於市場情況來做調整。

二零零七年第二季指引

以下聲明為前瞻性陳述，此陳述基於目前的期望並涵蓋風險和不確定性，部分已於之前的安全港聲明中闡明。

銷售額預期與二零零七年第一季度持平。

折舊及攤銷預期約介於5,000,000元至8,000,000元之間。

資本支出預期約介於50,000,000元至500,000,000元之間。

經營費用相對銷售的百分比預期5%左右。

近期公佈

二零零六年度報告發佈(二零零七年四月二十四日)

董事會延期舉行。(二零零七年三月二十九日)

中芯國際參加2007年3月21日。(二零零七年三月二十一日)

中芯國際與SMC、IBM、ASML、在華上海合夥建立 測試聯合實驗室(二零零七年三月十五日)

合併營運報表
(美元)

	截至以下日期止三個月	
	二零零七年 三月三十一日 (未經審核)	二零零六年 十二月三十一日 (未經審核)
銷售額	5, 3, 0	5, 3, 0
銷售成本	3, 3, 4	1, 4, 3, 5
毛利		
經營費用：		
研究和開發	0, 0, 55	0, 0, 5
一般及行政		